サイズ： W1600×H1000mm ／ 実寸スケール

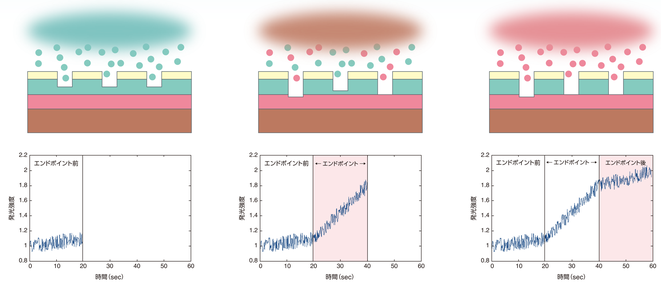
エンドポイントモニタリング

End Point Detection

お悩み 01　エッチングプロセスのエンドポイントを検知したい

▶ 発光スペクトルによって、どの波長がエンドポイントに最適であるかを見極めることで解決

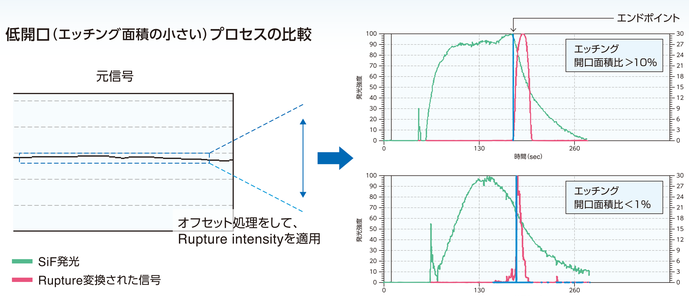
■ 発光スペクトル波長



お悩み 02　低開口プロセスのエンドポイントを検出したい

▶ 強力なエンドポイントアルゴリズム“Rupture intensity”により、非常に小さな信号の変化を的確に検出することで解決

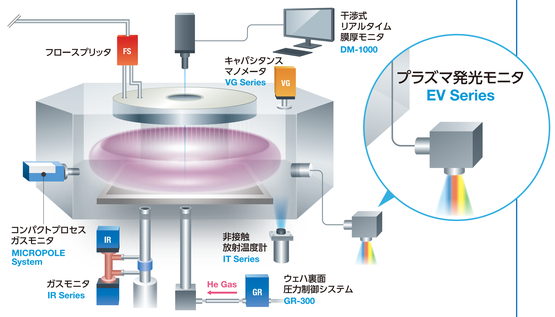
■ 低開口（エッチング面積の小さい）プロセスの比較



HORIBAのソリューション

プラズマ発光モニタ EV Series

プラズマを利用した薄膜プロセスにおいて、エンドポイントの検出やプラズマのコンディション管理を行うには、発光分析方式のエンドポイントモニタが必要です。
HORIBAは、分光器単体のご提案と、高度なソフトウェアを組み合わせたEV-140C/EV2.0を用途に応じて提案いたします。



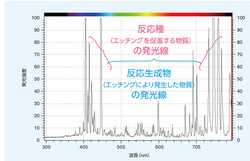
製品ラインナップ／ソフトウェアのご紹介

プラズマ発光モニタ EV-140C

特　長

- 開口比F/2の明るいグレーティングを採用
- 素子数2048×64 高感度・高分解能の裏面入射型CCDラインセンサ搭載
- 高度なプロセスコントロールを実現するソフトウェアSigma-P

■ エッチング中のプラズマ発光分光



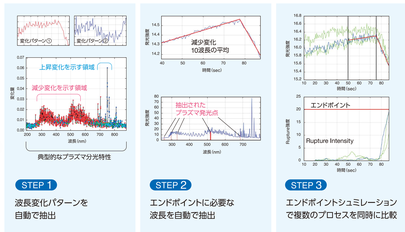
発光強度の弱いプロセスでも高感度に測定が可能

プラズマ発光モニタ EV2.0

特　長

- 200～1050nmの波長領域を一括で分析
- 分解能：最小1nm
- 最小5msecの応答速度

■ Recipe Designer 設定例



用途に応じた多彩なレシピ設計により、異常時などに判断が容易になります。